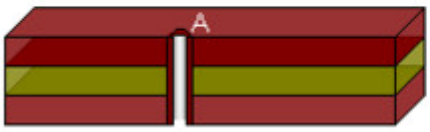
Zweiseitige Leiterplatte 0,8 mm

Lagenaufbau

Ebene		Komponente	Dicke (mm)	Cu (my)	Typ
1		Cu+galv.Cu	0.764	18+25	
		Tr-Lam			
2		Cu+galv.Cu		18+25	

Basismaterialdicke:	0,80	+/- 10 %
Gesamtdicke inkl. galv. Cu u. Lötstoppmaske:	0,91	+/- 10 %

Bemerkungen zum Lagenaufbau:

- minimale Kupferenddicken gemäß IPC 6012 aktuelle Ausgabe
- abhängig von gewählter Kupferdicke abweichende Isolationsdicke

Designrules zum Lagenaufbau

Durchgangslöcher [A] (Vias)	End-Ø	≥ 150 µm
	Viapad-Ø	≥ 450 µm
Leiterbild Außenlagen		
Standard	Leiterbreite bei 18 µm Grundkupfer	≥100 µm
	Leiterabstand bei 18 µm Grundkupfer	≥ 120 µm
	Leiterbreite bei 35 µm Grundkupfer	≥ 130 µm
	Leiterabstand bei 35 µm Grundkupfer	≥ 175 µm
	Leiterbreite bei 70 µm Grundkupfer	≥ 190 µm
	Leiterabstand bei 70 µm Grundkupfer	≥ 240 µm

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com

Zweiseitige Leiterplatte 0,8 mm

Leiterbreite bei 105 µm Grundkupfer	≥ 250 µm
Leiterabstand bei 105 µm Grundkupfer	≥ 320 µm

KSG GmbH
Auerbacher Str. 3-5
09390 Gornsdorf

Tel. +49 (0)3721-266-0
Fax +49 (0)3721-266-175
E-Mail: sales@ksg-pcb.com